

UI Science Profile

Equipment for next generation



2024. 04.01

Profile

- **회사명** **UI SCIENCE 주식회사**

- **주소** **187-1 Nanakoudai, Noda City, Chiba Prefecture, 278-0051, Japan**
Tel04-7137-7383 Fax 04-7137-7384

- **개요** **창립 2016년 9월**
자본금 JPY100,000,000
거래은행 The Chiba Bank ,Ltd.
대표이사 우메모토 신이치



Introduction of UI SCIENCE

장비Concept

- ✓ 당사는 20년간 도금장비의 기술을 축적한 도금장비 메이커 입니다.
- ✓ 당사의 장비는 고객의 사양을 기반으로 하여 설계된 오리지널 오더메이드 장비 입니다.
- ✓ 당사의 장비는 공간절약, 에너지절약, 러닝코스트 절약을 대응하고 있습니다.

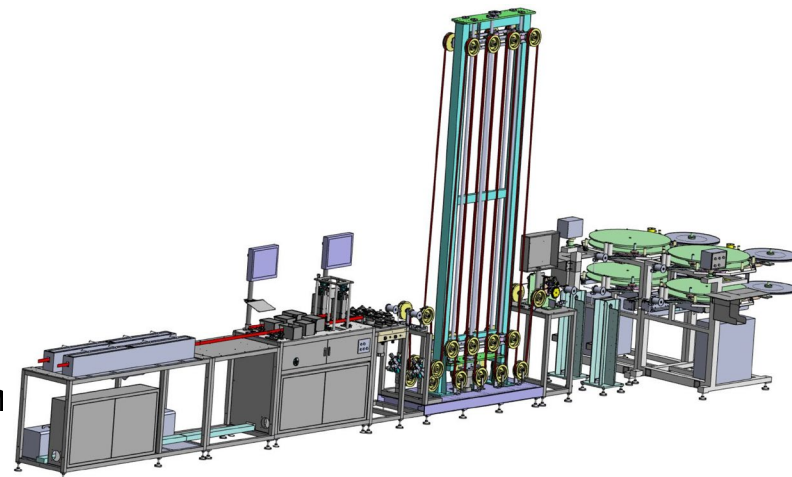
장비종류 Full/Semi Auto Wafer 도금장비
 UBM Auto Wafer 도금장비
 R to R Connector 부분도금 장비
 Lead Frame도금장비,
 Cut Strip R to R 도금장비
 자동반송기, 실험장치, 의료기기
 각종 도금지그 (Mold가공 Silicon Mask)



Introduction of Plating Equipment

RtoR Connector 부분도금장비

- 모델 명칭 : UIRC-02 ~ 04
- 라인수 : 2조 ~ 4조 (최대4조)
- 반송처리속도 : 1.0~25.0m/min
- 대상제품 : 컨넥터류, 또는 후프류
- 기본처리사양 : 전면Ni + 부분Pd +부분Au + 부분Sn
: 전면Cu +전면Sn +리플로우 등
- 대상재질 : Cu합금, SUS등



장비설계Concept

- Fine Pitch Micro컨넥터 제품을 안정반송, 고품질 도금대응가능
- 차량용 컨넥터 제품을 안정반송, 고품질 도금대응가능
- 각종 부분도금 및 치구가공에 의한 부분도금 고정도 대응가능
- 작은공간에 Compact한 설계의 Concept
- Energy Saving, Maintenance Free



Introduction of Plating Equipment

Full Auto 웨이퍼도금장비

- 모델 명칭 : UIWA-03 ~ 012
- 도금Cup수 : 4 ~ 8Cup (최대8Cup)
- 생산매수 : 약 3,000 매/월
- 대상제품 : 3" 4" 5" 6" 8" 12inch
- 기본처리사양 : Au, Cu, Ni, Sn
- 대상재질 : Silicon Wafer, GaAs Wafer, GaN Wafer, 기타



장비설계Concept

- 스칼라로봇 탑재로 안정반송, 고품질 도금대응가능
- 오리지널 Face Down 컵구조로 고품질 도금대응가능
- 각종 부분도금 및 치구가공에 의한 부분도금 고정도 대응가능
- 작은공간에 Compact한 설계Concept
- Energy Saving, Maintenance Free



Introduction of Plating Equipment

Semi Auto/Manual 웨이퍼도금장비

- 모델 명칭 : UIWA-03 ~ 012
- 도금Cup수 : 2 ~ 14Cup (최대14Cup)
- 생산매수 : 약 9,000 매/월
- 대상제품 : 3" 4" 5" 6" 8" 12inch
- 기본처리사양 : Au, Cu, Ni, Sn
- 대상재질 : Silicon Wafer, GaAs Wafer, GaN Wafer, 기타



장비설계Concept

- 오리지널 Face Down 컵구조로 고품질 도금대응가능
- 작은공간에 Compact한 설계Concept
- Energy Saving, Maintenance Free
- 2컵~14컵, 오더메이드



Introduction of Plating Equipment

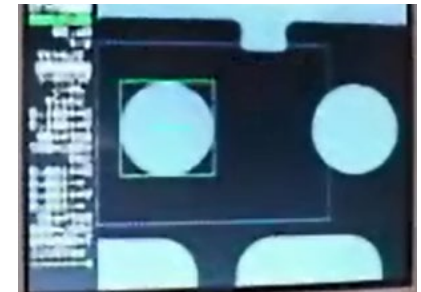
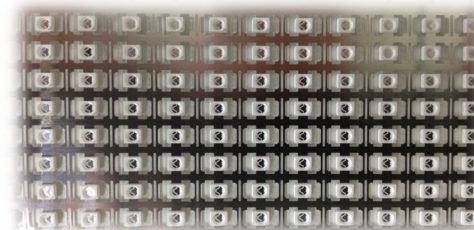
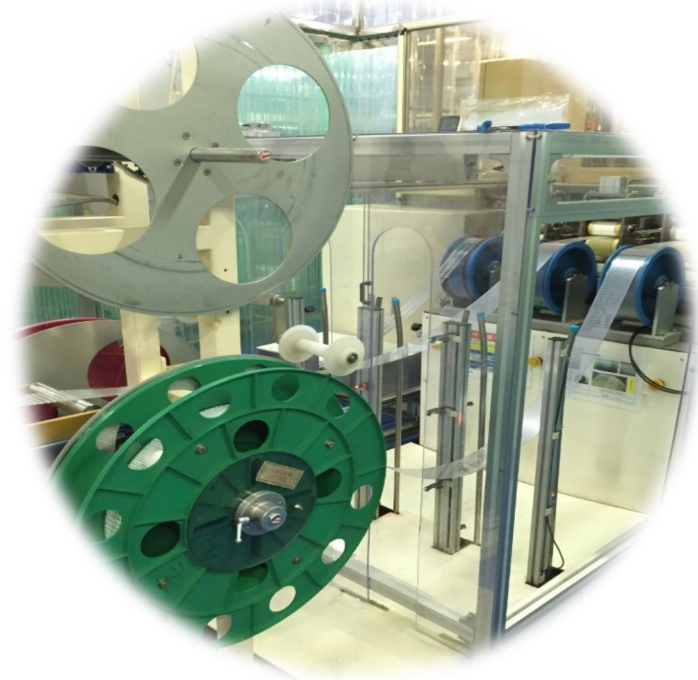
Lead Frame 도금장비

RtoR타입 부분도금장비

- 모델 명칭 : UIRLF-02 ~ 04
- 라인수 : 2조 ~ 4조 (최대4조)
- 반송처리속도 : 2.0 ~ 5.0 m/min
- 대상제품 : Cu재, 42AL재, 기타
- 기본처리사양 : Cu, Ni, Ag, Au, Sn

장비설계Concept

- 오리지널 도금지그 (몰드마스트 타입) 로 품질 도금대응가능
- 스팟도금정도 ± 0.07 이하달성
- 작은공간에 Compact한 설계Concept
- Energy Saving, Maintenance Free



Introduction of Plating Equipment

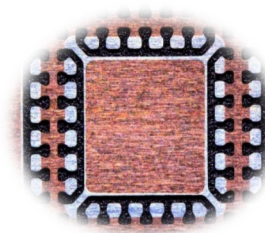
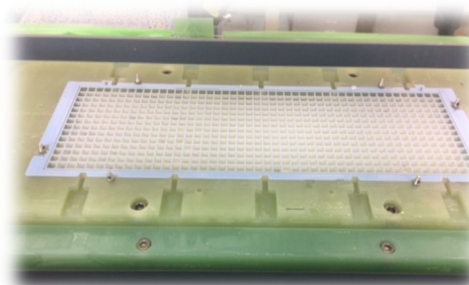
Lead Frame 도금장비

Cut Stripe Type 부분도금장비

- 모델 명칭 : UICLF-02 or 04
- 라인수 : 4열 (최대6열)
- 반송처리속도 : 1.6 ~ 2.0 m/min
- 대상제품 : Cu재, 42AL재, 기타
- 대응제품치수 : 폭 20 ~ 110 mm
길이 120 ~ 300 mm
두께 0.10 ~ 0.25 mm
- 기본처리사양 : Cu, Ni, Ag, Au, Sn

장비설계Concept

- 오리지널 도금지그 (Mold Mask 타입) 로 품질 도금대응가능
- Spot도금정도 ± 0.07 이하달성
- 좁은 Space에 적합한Compact한 설계
- Energy Saving, Maintenance Free

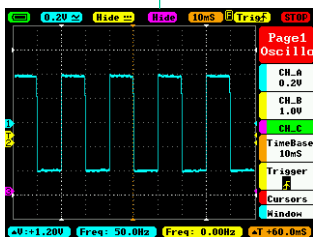
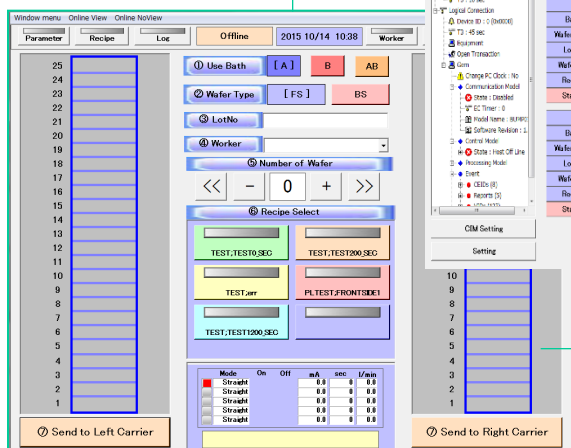


Introduction of Control System

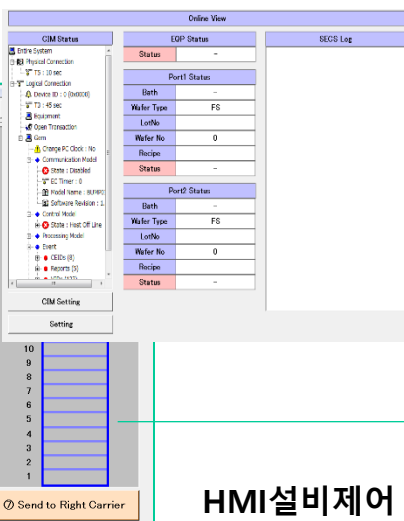


고객HOST서버
SECS/GEM
온라인(HOST통신)

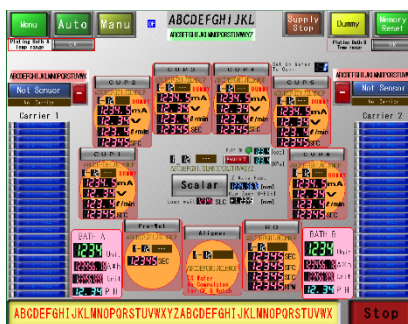
PC(데이터제어)



전류,기판,펌프제어



HMI설비제어



당사 취급의 모든 장비는
다양한 네트워크 기기제어가 가능
희망하는 인라인 컨트롤을 실현합니다.

- 설비제어 (반송, 로봇제어등)
- 레시피D/L, 데이터수집, 경보이력관리 (PC제어)
- 레시피U/L, 호스트통신관리 (온라인제어)



PLC(설비제어)

Melsecnet /H



Ethernet

CC-Link
FA통신



Ethernet

RS-232C통신



다관절로봇(다축제어)



범용화상검사장치
인라인 화상검사

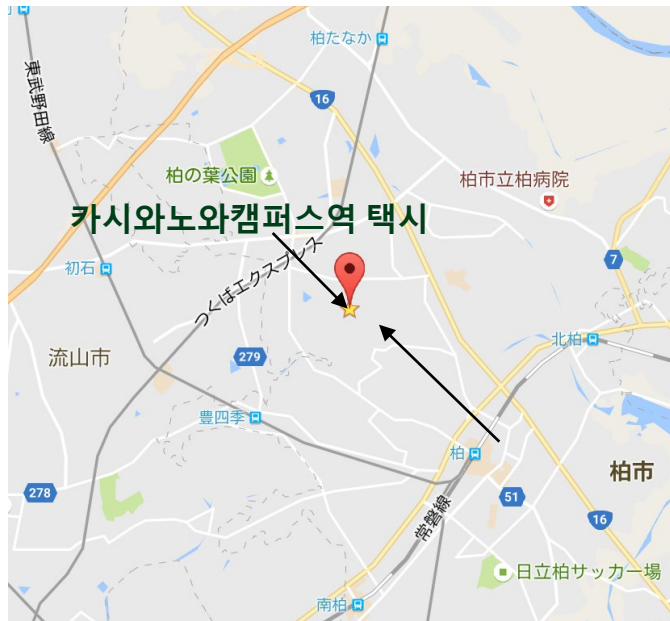
Access to UI SCIENCE

근처 역까지 오시는 방법

도쿄역에서 전철로 35분

하네다 공항에서 전철로 60분, 버스 75분

나리타 공항에서 전철로 60분, 버스 90분



head office & Noda factory
semiconductor Iruma factory
Ome branch

